



Micro-Hybrid Electronic GmbH

Die *Micro-Hybrid Electronic GmbH* wurde im Jahr 1992 von *Dipl.-Ing. Werner Baumgärtel* und *Dipl.-Ing. Karl Wißpeintner* im ostthüringischen Hermisdorf gegründet. Nach dem Beginn mit 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind – in Kooperation mit der Tochterfirma *Mikrotechnik + Sensorik GmbH* und auf Basis eines kontinuierlichen Wachstums – gegenwärtig 102 hoch qualifizierte Fachkräfte beschäftigt. Geschäftsführer ist *Dr. Knuth Baumgärtel*.

Electronic Manufacturing Service (EMS) und IR-Sensorik sind die Kerngeschäfte. Als Elektronikdienstleister übernimmt *Micro-Hybrid* die Entwicklung, Anpassungsentwicklung und das Layout von Baugruppen – sowohl in Hybridtechnik, auf Leiterplatten, als auch in Kombination beider.

Für die Fertigung werden Beschaffung, Bearbeitung, Bestückung, Abgleich und Prüfung von Leiterplatten- und Hybrid-Baugruppen durchgeführt. Als Spezialist in der Aufbau- und Verbindungstechnik entwickelt und fertigt *Micro-Hybrid* kundenspezifische Schaltungen für die

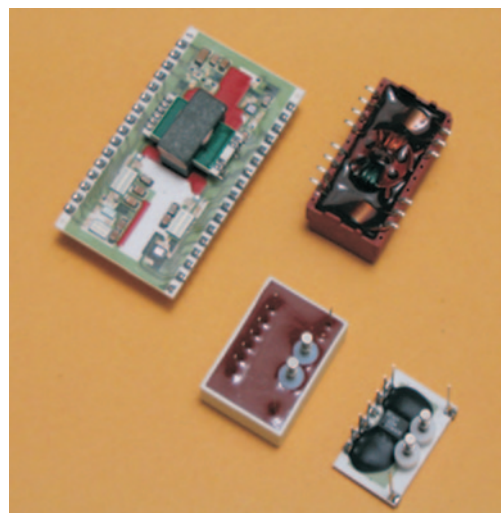


Komplettmodul Thermopile-Zeile

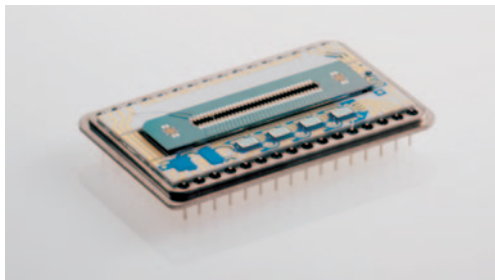
Automobil-, Medizin- und Luft- & Raumfahrtindustrie. Ferner sind Kompetenzen in der IR-Sensorik vorhanden, z.B. für die berührungslose Temperaturmessung bzw. die Gasanalyse bis hin zur Komplettierung zu intelligenten Baugruppen.

Die Hauptgeschäftsfelder Hybridtechnologie, Leiterplattenbestückung und Packaging werden von Technologien im Reinraum wie Chip- und Draht-Bonden, diversen Passivierungen, Verschluss, Komplettierung von Funktionsmodulen sowie umfassenden Endkontrollen ergänzt. Chips und Elektronik werden hermetisch dicht verpackt und verschlossen. Der Verschluss erfolgt in Metall-Glas- bzw. in keramischen Gehäusen. Auf Wunsch wird das System mit einem Füllgas gefüllt. Zur Prüfung der Produkte werden verschiedene Testsysteme einschließlich AOI und In-Circuit-Test genutzt.

In der IR-Sensorik zählen die Detektoren auf Basis der zum Einsatz kommenden Thermopile-Chips (Thermosäulen) zu den empfindlichsten IR-Detektoren der Welt. Sie basieren auf sehr effizienten Metallkombinationen wie z.B. Wismut/Antimon. Hierdurch erreichen die Detektoren eine sehr hohe Empfindlichkeit bei ausgezeichneter



Hybridbaugruppen, auch mit COB und Verguss/Passivierung



Thermopile-Zeilenmodul



Kraftsensorik

Signalstabilität und einem sehr guten Signal/Rausch-Verhältnis.

Bei allen laufenden Serien mit verschiedenen Füllgasen haben die Detektoren Leckprüfungen, genaue Parameteranalysen und andere in Typprüfprogrammen definierte Tests zu absolvieren.

Spezielle OEM-Lösungen in der Kraft- und Beschleunigungssensorik werden gemeinsam mit der Tochterfirma *Mikrotechnik + Sensorik GmbH* realisiert.

Seit 2007 betreibt die *Micro-Hybrid Electronic GmbH* ein Forschungslabor auf dem Campus der *Technischen*

Universität Ilmenau. Modernste Mess- und Prüftechnik, Muster- und Prototypenbau sowie die Zusammenarbeit mit dem *ZMN (Zentrum für Mikro- und Nanotechnologien)* erlauben hier zusätzlich grundlegende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Mikrosystemtechnik.

Eine durchgängige Überwachung aller Prozesse entsprechend der DIN EN ISO 9001 garantiert eine gleich bleibend hohe Qualität der Fertigung.

Micro-Hybrid Electronic GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 8, 07629 Hermsdorf/Thüringen, Tel. 036601/5921-00, Fax -10, contact@micro-hybrid.de, www.micro-hybrid.de

INTERCONEX 2008

Call for papers

IMAPS Frankreich veranstaltet am 24./25. Juni 2008 im Centre de Congrès de la Villette-Paris das 18. *Forum für Verbindungstechnik und Mikroelektronik-Packaging*. Hierfür werden Beiträge **bis spätestens 29. Februar 2008** zu den folgenden Schwerpunkten gesucht:

- materials and new processes: lead-free, polymers, assembly process, intraconnections
- printed circuit boards, new technologies

- large BGA packages
- advanced packaging and interconnection technologies: SiP, 3D packaging, wafer level packaging, ...
- electronics on flexible support
- applications: microsystems, power, medical, telecommunication, automotive industries
- modelling, simulation
- thermal management
- test, reliability and characterization

Kontaktperson für Rückfrage und die Einreichung von Abstracts ist Florence Vireton, Tel. +33/1/39671773, Fax +33/1/39027193, imaps.france@imapsfrance.org

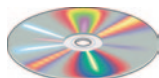
Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
München	21./24.4.2008	CICMT 2008	IMAPS NA, AcerS, DKG, IMAPS D
London, Old Windsor	11./12.6.2008	Micro Tech 2008	IMAPS UK
Greenwich	1./4.9.2008	ESTC 2008	IEEE/CPMT

Das traditionelle Seminar im Februar entfällt in diesem Jahr! Der Grund dafür ist die Ausrichtung der *4th Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies Conference (CICMT)* vom 21. - 24. April 2008 in München.

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings der *IMAPS-Herbsttagung 2007*, die am 8./9. Oktober 2007 in München stattgefunden hat, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

und als Papiaausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2006*, die am 10. und 11. Oktober 2006 in München durchgeführt wurde, und der *Deutschen IMAPS-Seminare 2006 und 2007* zu den Themen *Muss jeder Sensor smart sein?* (Februar 2006 in Göppingen) und *Flip Chip – die Alternative zum Drahtbonden?* (Februar 2007 in Ilmenau) sind noch erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps, c/o Hesse & Knipps GmbH, Vattmannstraße 6, D-33100 Paderborn, Fax: 05251/1560-97, hans-ulrich.knipps@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Neuer Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland



Liebe Mitglieder und Interessenten,

der neu gestaltete Webauftritt von *IMAPS Deutschland* ist nun seit einigen Wochen online. Hatten Sie schon einmal Gelegenheit, sich umzusehen?

Außer einem frischen Erscheinungsbild sind im Vergleich zu bisher auch mehr Informationen verfügbar. Wir würden gern auch Ihre Meinung und Vorstellungen zukünftig einfließen lassen wollen. Wenn Sie Anregungen und

Wünsche haben, können Sie diese gern an den Vorstand senden.

Sie finden die Webseiten von *IMAPS Deutschland* im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von *IMAPS* erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

<http://www.imapseurope.org>

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller

1. Vorsitzender

c/o ZiK MacroNano

Applikationszentrum Ilmenau

Gustav-Kirchhoff-Str. 5

98693 Ilmenau

Fon: 03677/69-3381

Fax: 03677/69-3379

e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar

2. Vorsitzende

c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie

Albrecht-Erhard-Str. 17

D-73433 Aalen

Fon: 07361/931129

Fax: 07361/943004

e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps

Schatzmeister

c/o Hesse & Knipps GmbH

Vattmannstraße 6

D-33100 Paderborn

Fon: 05251/1560-14

Fax: 05251/1560-97

e-mail: hans-ulrich.knipps@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer

Schriftführer

c/o FH Schmalkalden

FB Elektrotechnik

D-98574 Schmalkalden

Fon: 03683/688-5116

Fax: 03683/688-5499

e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit
und Mikrointegration
Chip Interconnection Technologies
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
Fon: 030/46403-164
Fax: 030/46403-161
e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VIA electronic GmbH
Robert-Friese Straße 3
D-07629 Hermsdorf
Fon: 036601/81-529
Fax: 036601/81-530
e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
D-10623 Berlin
Fon: 030/310078-242
Fax: 030/310078-256
e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe
Öffentlichkeitsarbeit
c/o TU Ilmenau
Fakultät EI

FG Mikroperipherik
Pf 100565
D-98684 Ilmenau
Fon: 03677/69-3429
Fax: 03677/69-3350
e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH
Klein Grötzing
D-84494 Neumarkt-St. Veit
Fon: 08722/9620-0
Fax: 08722/9620-30
e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter
Öffentlichkeitsarbeit
c/o FHTE Standort Göppingen
Robert-Bosch-Str. 1
D-73037 Göppingen
Fon: 07161/679-157
Fax: 07161/679-233
e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann
Öffentlichkeitsarbeit
EADS Deutschland GmbH
Microwave Factory / Defence Electronics
Woerthstr. 85
D-89077 Ulm
Fon: 0731/392-3879
Fax: 0731/392-3362
e-mail: martin.oppermann@imaps.de

Lexikon Elektronik-Fertigung 2006/2007

1. Auflage (als eigenständiges Buch) von Dr. Rolf Biedorf. 448 Seiten.
ISBN 3-87480-218-3. Preis € 55,- inkl. MwSt. zzgl. Porto und Verpackung.

Das *Lexikon Elektronik-Fertigung* war seit 1994 als Teil des *Branchenführers Elektronikfertigung* kontinuierlich auf inzwischen 7300 lexikalisch erläuterte Begriffe, Abkürzungen und in der deutschen Sprachliteratur verwendete Anglizismen sowie mehr als 400 Abbildungen, Schemata und Diagramme angewachsen. Dieser Umfang hat es sinnvoll erscheinen lassen, ein eigenständiges Lexikon zu schaffen. Das Buch führt Außenstehende durch die Branche, und mit geringstem Aufwand werden der Zugang zu benachbarten Gebieten sowie wissenschaftliche, technologische und organisatorische Grundlagen angeboten.

Eugen G. Leuze Verlag KG

Karlstraße 4 · D-88348 Bad Saulgau · Tel. 07581/4801-0 · Fax 07581/4801-10
buchbestellung@leuze-verlag.de · www.leuze-verlag.de